

HSL-697 热封试验仪



应用范围

适用于各种塑料薄膜、复合膜、铝箔、PVC 硬片等材料热封性能参数的测定。

主要特点

- 触摸屏操作，工业 TFT 屏
- 零导航深度的扁平化界面 UI，操作更加方便快捷
- 封刀温度、热封时间触摸屏设定
- 双刀温度独立控制
- 微型打印机打印试验报告
- 安全急停设计，防烫设计
- 无风扇，零工作噪音
- 支持全天候 300℃ 高温
- 配置标准通信接口
- 支持 DSM 实验室数据管理系统，可实现数据统一管理（另购）

技术指标

热封温度：室温+6℃~300℃

控温精度：±0.2℃

热封时间：0.1~999.9s

热封压力：0.05MPa ~ 1.1MPa

热 封 面：265mm × 12 mm（可定制）

热封形式：双刀独立控制

气源压力：0.05MPa ~ 1.1MPa（气源用户自备）

气源接口：Φ6mm

外形尺寸：410 mm (L) × 396 mm (B) × 416 mm (H)

电 源：AC 220V 50Hz

净 重：33kg

执行标准

QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB00212005-2015

产品配置

标准配置：主机、脚踏开关、微型打印机、试样杆

选 购 件：通信电缆、DSM 实验室数据管理系统

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权！